

金禄电子科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极响应深圳证券交易所“关于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的倡议”，切实提高经营质量和投资回报水平，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案并经公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》，董事会对上述行动方案的实施进展进行了专项评估，现将有关情况公告如下：

一、行动方案的实施情况及效果

（一）持续聚焦主业，提升经营质量

2026年上半年，公司持续聚焦主业发展，加快构建“1+6+N”的层次分明、协同联动的产品应用格局。公司加大力度、更加坚决地开展产品调价工作，以产业链定价权逐渐前移及行业普遍缺料背景下保障产品供应为契机，强化与主要客户的合作关系，积极调整订单结构，上半年承接的订单金额同比增长101.14%（其中承接的订单数量同比增长55.89%，承接的订单平均单价同比增长29.03%）。尤其是第二季度以来，公司先后与所有主要客户（个别招投标客户除外）就产品调价机制或调价幅度达成一致，使得第二季度承接的订单平均单价环比第一季度增长21.77%，订单价格的涨幅预计在下半年体现得更为充分和明显。

受产能同比提升、订单充沛及产品价格上调的影响，公司2026年上半年实现营业收入133,987.46万元，同比增长43.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5,563.48万元，同比增长6.26%，其中第二季度归属于上市公司股东的净利润为4,672.23万元，环比增长424.23%，同比增长26.89%，已扭转第一季度的经营颓势，盈利能力得以改善并向好发

展。

报告期内，公司加快推进广东清远生产基地PCB扩建项目及湖北安陆生产基地多层板扩能项目的建设。截至本公告披露日，湖北安陆生产基地多层板扩能项目已完成建设并投产，新增多层板产能2.5万平米/月。根据目前实际建设情况，广东清远生产基地PCB扩建项目首条适配AI和算力产品的生产线预计将在第三季度内建成并投产。上述项目相继投产后将极大缓解公司目前面临的产能瓶颈，同时有助于新兴产业应用领域客户的导入和订单的承接。

（二）强化科技创新，发展新质生产力

2026年上半年，公司深入贯彻创新驱动发展战略，研发投入金额为6,224.30万元，同比增长31.80%。公司有序推进新兴产业应用领域的产品研发和试制工作，应用于卫星相控阵天线领域的26层多次混压埋阻电路板、AI服务器二次电源领域的16层2阶HDI厚铜电路板、货运eVTOL领域的BMS电路板等产品已试制成功并交客户验证；应用于人形机器人一体化关节模组、AI数据中心UPS、AI服务器连接器、边缘算力盒子等领域的PCB已由试制转为量产；固态电池、汽车AI-box等领域的PCB新产品研发工作积极配合下游客户的改版优化、量产规划予以推进，公司正在加快产品技术薄弱环节的攻坚克难，围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶HDI等方向聚力突破。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平

2026年上半年，公司紧跟上市公司监管政策要求，持续推动完善法人治理结构。针对《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等修订情况、《上市公司董事会秘书监管规则》的发布实施以及落实广东证监局《关于上市公司建立健全高管薪酬管理机制的工作提示》《关于强化董秘合规履职的工作提示》等要求，公司系统性梳理董事与高级管理人员的薪酬管理、绩效与履职评价、董事会秘书履职等内控机制，已于报告期内制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并修订《董事、高级管理人员行为规范》《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》《董事、高级管理人员离职管理制度》，已于本公告日披露了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员行为规范》等修订情况。

报告期内，公司积极组织董事、高级管理人员参加广东上市公司协会举办的培训活动，强化对上市公司高质量发展、公司治理质量提升、内幕交易防控等的理解与认识。与此同时通过内部审计自查自纠、上市公司违规案例学习借鉴等机制识别若干内控缺陷并进行了有效整改。

（四）提升回报水平，增强投资者获得感

公司牢固树立回报股东意识，持续实施对股东较高比例利润分享的政策。2026年上半年，公司实施完毕了每10股派发现金红利1.50元（含税）并使用资本公积每10股转增4股的2025年度利润分配方案。鉴于公司2026年上半年合并报表经营性现金流量净额为负数，不满足股东会授权董事会的2026年中期现金分红的条件，因此未在半年度提出中期现金分红方案。

（五）提升信息披露质量，加强投资者沟通

2026年上半年，公司持续夯实信息披露质量，在指定信息披露媒体累计披露公告及其他相关文件70份，以合法合规为准绳，以投资者合理诉求为考量，积极提升信息披露工作服务投资者价值判断与投资决策的意识和能力。为回应投资者在公司股价出现较大波动的背景下普遍关注的有关事项，公司于2026年6月11日主动披露了《关于近期投资者关注有关事项的情况说明公告》，就公司日常经营情况、股权激励情况、股东减持情况等事项进行了说明。

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，畅通互动易/投资者热线/邮箱等沟通渠道，通过上述方式累计回复投资者咨询138次，其中对互动易平台提问的回复率为100%。公司于2025年年度报告披露后召开了年报业绩说明会，并于本公告日披露了《关于举行2026年半年度业绩说明会的公告》，定于2026年8月18日召开2026年半年报业绩说明会，通过增加定期报告业绩说明会召开频次加强与投资者的沟通、倾听投资者的意见和建议。

二、投资者关于改进方案的意见建议

报告期内，公司“质量回报双提升”行动方案披露后，投资者反馈的意见建议主要包括对标PCB上市公司提升市值管理能力、加快算力基础设施应用领域的业务拓展、股价出现大幅波动时采取稳定股价的措施、加强对外交流增进机构投资者对公司的认知等。针对上述意见建议，公司将结合实际情况予以认真研究。

三、进一步改进措施

为进一步落实“质量回报双提升”行动方案，下半年公司将采取如下改进措施：

1、通过产品持续调价、优化客户及订单结构等方式积极修复盈利能力，提升公司经营业绩；

2、努力改善第三季度经营性现金流，在满足股东会授权董事会的2026年中期现金分红条件的前提下制定并实施2026年中期现金分红方案；

3、在2026年第三季度报告披露后召开业绩说明会并适时举办投资者开放日活动。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十四日